

证券代码：301678

证券简称：新恒汇

公告编号：2026-013

新恒汇电子股份有限公司

2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 239,555,467 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	新恒汇	股票代码	301678
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张建东	宗晓艳	
办公地址	山东省淄博市高新区中润大道 187 号	山东省淄博市高新区中润大道 187 号	
传真	0533-3982701	0533-3982701	
电话	0533-3982031	0533-3982031	
电子信箱	zjd@henghuiic.com	zxy@henghuiic.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司的主要业务涵盖智能卡业务、蚀刻引线框架业务和物联网 eSIM 芯片封测三个板块。根据中国证监

会《上市公司行业统计分类与代码》和国家统计局《国民经济行业分类》，公司所处行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”中的“集成电路制造业（C3973）、电子专用材料制造（C3985）”，具体细分行业为集成电路封装材料及封测服务业。

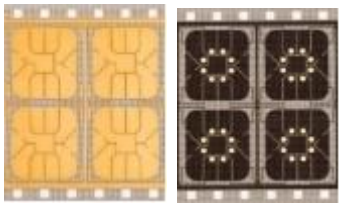
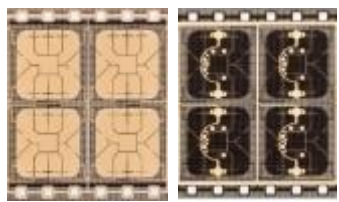
（1）智能卡业务

1) 柔性引线框架产品。柔性引线框架是用于智能卡芯片封装的一种关键专用基础材料，主要起保护芯片及作为芯片和外界刷卡设备之间的通讯接口的作用。其生产采用卷式连续生产方式，产品效果图如下：



柔性引线框架产品按照智能卡与刷卡设备之间的通讯方式不同，分为接触式单界面产品和同时具有接触与非接触两种通讯方式的双界面产品。与单界面产品相比，双界面产品材料成本高，生产工艺复杂，因此双界面产品的销售价格也远高于单界面产品，通常一个双界面产品售价是大约单界面产品的 4 倍左右。

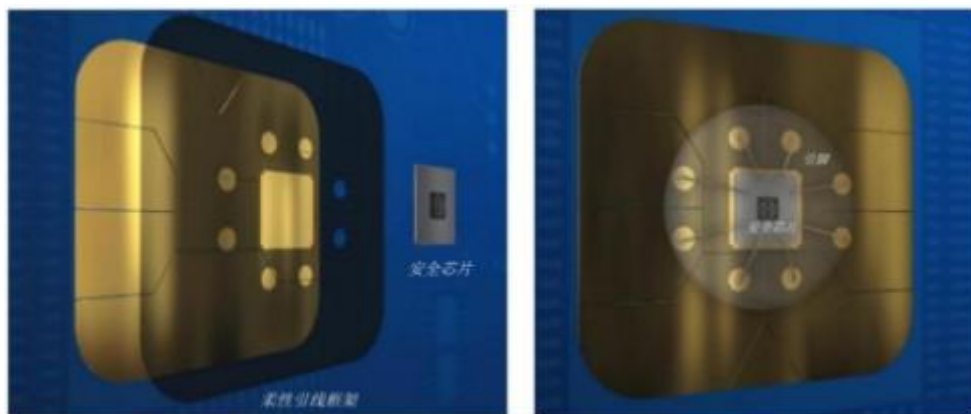
公司的柔性引线框架产品主要分为单界面产品和双界面产品，具体情况如下：

产品类型	图示	产品介绍	应用领域
单界面柔性引线框架	 <p>接触面 焊接面</p>	单界面产品需要在环氧树脂布双面贴铜，贴铜材料经过十几道生产工序，在铜材料上刻画出几十微米粗细与间距的线路图案，精度要求高。单界面产品根据外部通讯接口数目可细分为 6PIN、8PIN 两类产品	电信 SIM 卡、民生卡（如加油卡、会员储值卡、燃气卡、公交卡、水卡）等领域
双界面柔性引线框架	 <p>接触面 焊接面</p>	双界面产品需要在环氧树脂布双面贴铜，两面分别刻蚀电路，并通过金线焊接实现芯片与模块天线的连接，模块天线可通过导电柱与卡片天线连接，从而实现非接触式功能。按芯片与外部设备通讯接口数目不同，双界面产品可细分为 6PIN、8PIN 两类产品	金融卡、ETC 卡等领域

柔性引线框架正面为接触面，制成智能卡后接触面要与外部读卡设备稳定通信，产品表面要求导电性好、光洁无划痕，在复杂外部环境中长期使用不能生锈腐蚀，经常插拔后不影响产品的正常导电。

柔性引线框架的背面是焊接面，安全芯片被贴合在柔性引线框架背面后，通过金属丝（通常是金丝或者金银合金丝）键合，将芯片的通讯触点与柔性引线框架的焊盘一一对应键合在一起。键合的过程要求柔性引线框架的焊盘具有极好的可焊接性和洁净度。

2) 智能卡模块产品。柔性引线框架产品与芯片一一对应被封装成智能卡模块。智能卡模块是智能卡生产中的一个中间产品，其主要的生产过程是将安全芯片逐个贴合到柔性引线框架的背面，经过粘合、键合、包封、固化、测试、检验等程序后，完成智能卡模块产品生产和出库。智能卡模块被智能卡制造商制作成智能卡片后供客户使用。智能卡模块生产采用卷式连续生产的方式，产品效果图如下：



智能卡模块拆解图示智能卡模块焊接面效果图

按照安全芯片所有权的不同，公司向客户提供的智能卡模块产品分为两类：一是客供芯片，公司使用自产的柔性引线框架来封装芯片，加工成智能卡模块产品后向客户销售；二是公司向安全芯片设计厂商购买晶圆裸片，并使用自产的柔性引线框架进行封装，形成自有品牌智能卡模块产品后向客户销售。

公司的智能卡模块产品主要分为单界面产品、双界面产品和非接触式产品，具体情况如下：

产品类型	图示	产品介绍	应用领域
单界面模块	<p>接触面 焊接面</p>	<p>每个焊接面中央处的黑色小物体为智能卡安全芯片。单界面模块为单界面智能卡的核心部件，在工作时需要与读写终端的触点接触（例如可以插进手机的 SIM 卡）。单界面模块可细分为 6PIN、8PIN 两种形式。</p>	<p>电信 SIM 卡、民生卡（如加油卡、会员储值卡、燃气卡、公交卡、水卡）等领域</p>
双界面模块	<p>接触面 焊接面</p>	<p>双界面模块为双界面智能卡的核心部件，双界面卡是兼具接触式和非接触式卡片通信功能的智能卡（例如既可以插进 POS 机刷卡，也可以间隔一段距离通过天线感应刷卡的银行卡）。双界面模块可细分为 6PIN、8PIN 两种形式。</p>	<p>金融卡、ETC 卡等领域</p>
非接触式模块	<p>正面 背面</p>	<p>非接触式模块为非接触式智能卡的核心部件，非接触式智能卡在读取过程中无需与读写终端的触点接触，只需在读写终端一定范围内即可快速完成信息的读写，具有方便、快捷、无磨损消耗等优点，但其在应用过程中的安全性不如接触式智能卡。</p>	<p>身份证、护照、交通卡等领域</p>

（2）蚀刻引线框架产品

引线框架的主要功能是为脆弱而精细的集成电路裸片提供支撑、负责内外部电路导通及向外散发热量等功能。芯片只有经过封装后，才可以焊接到电路板上。芯片与外部电路板之间的电信号传导，需要通过引线框架来实现。引线框架按照生产工艺方式的不同可以分为冲压引线框架和蚀刻引线框架，目前国内蚀刻引线框架主要从日韩等国进口，自给率较低。

集成电路经过数十年发展，其封装形式已经多种多样，DRQFN、QFN、DFN、QFP、FC 是重要的封装形式。蚀刻引线框架是上述封装形式中的关键材料。在蚀刻引线框架的生产过程中，需要根据不同芯片的功能与结构布局，有针对性的设计引线框架的电路布局图，在金属铜箔上刻画出几十微米粗细与间距的电路结构，用于集成电路的封装。

公司的蚀刻引线框架产品生产主要采取卷对卷的生产方式。产品在出厂前，经过切割，形成大约 7 厘米宽 20 厘米长的条状产品形态，通常称为一条框架。每条框架上，根据芯片的大小，会有几十到数万颗对应芯片的连接电路图案。

（3）物联网 eSIM 芯片封测服务

由于物联网 eSIM 芯片通常应用于物联网智能终端，部分终端要长期处于自然界外部环境中，其使用环境与人类随时携带的智能卡使用环境不同，因此其环境耐受性与可靠性要求较高。

物联网 eSIM 芯片的封装，是将安全芯片进行减薄与切割后，与蚀刻引线框架上的电路一一对应贴合在一起，使用金属键合丝，将芯片上的触点与引线框架上的焊盘通过焊接连接起来，然后使用树脂、金属或者陶瓷，将芯片与焊接点电路包封起来，只露出引线框架的外焊接点，并再次对外部焊接点进行表面处理，以方便以后将集成电路与电路板之间进行焊接。封装好的芯片要经过测试，测试合格后出厂。

公司的物联网 eSIM 芯片封装主要是面向物联网身份识别芯片，封装形式主要是 DFN/QFN 封装以及 MP 封装，下游应用领域主要是可穿戴设备、物联网消费电子、工业物联网等领域。

（4）集成电路封测行业发展概况

2025 年，全球半导体行业在回暖复苏中加速重构，AI 算力需求爆发、产业转移持续深化、国产替代进程提速，随着全球终端消费市场回暖，产业链去库存周期基本结束，叠加 AI 应用场景不断涌现，集成电路行业整体景气度回升明显。据工信部和海关总署数据显示，2025 年我国集成电路行业增加值同比大幅增长 26.7%，电子专用材料行业增长 23.9%，显著领先于整体工业 5.9% 的增速，集成电路产量 4843 亿块，同比增长 10.9%；出口集成电路 3495 亿个，同比增长 17.4%，凸显出以集成电路为代表的战略性基础产业，正成为驱动工业高质量发展与经济增长的核心引擎之一。世界半导体贸易统计组织（WSTS）预测，2025 年全球半导体市场规模约为 7720 亿美元，同比增长 22%，而 2026 年市场规模约 9750 亿美元。

据智研咨询发布的《2026 版集成电路封测行业发展历程、市场概况及未来前景研究报告》显示，受益于国家产业政策的大力扶持以及下游应用领域的需求拉动，中国大陆集成电路封测市场跟随国内半导体产业实现稳步发展，市场规模持续扩大，2020-2025 年从 2509.5 亿元增长至 3533.9 亿元，年复合增长率达 7.09%。从业务结构来看，目前中国大陆封测市场仍以传统封装为主，2025 年先进封装占比约为 20.86%，与全球先进封装发展水平仍有一定差距。未来，随着全球集成电路产业重心持续向中国大陆转移，叠加下游新兴应用需求的持续释放，国内封测行业将继续保持增长态势，预计 2026 年市场规模将达到 3750.6 亿元。同时，国内领先封测企业持续加大先进封装领域研发与产能投入，叠加下游市场对先进封装需求的快速增长，先进封装市场占比有望稳步提升，预计 2026 年将达到 23.3%。

尽管中国大陆先进封装市场起步晚于全球市场，但近年来呈现快速追赶态势，发展势头强劲。从细分市场结构来看，与全球市场一致，FC 仍是中国大陆市场规模最大的先进封装技术，芯粒多芯片集成封装则是

增长最快的细分领域。与全球市场相比，中国大陆先进封装市场增长更具优势：一方面，我国拥有全球规模最大、增速最快的集成电路消费市场，为先进封装技术的落地应用提供了广阔空间；另一方面，在境外高端芯片及封装技术供应受限的背景下，国内市场对高算力芯片的需求持续攀升，芯粒多芯片集成封装成为实现高算力芯片自主发展的重要路径，进一步推动相关领域快速发展。受益于此，中国大陆先进封装市场复合增长率高于全球整体水平，尤其是芯粒多芯片集成封装等前沿领域，预计 2026 年其市场规模将达到 73.8 亿元，2022-2026 年年复合增长率高达 180%，成长潜力巨大。

据智研咨询发布的《2026 年全球及中国集成电路封测行业产业链、发展现状、细分市场、竞争格局及未来发展趋势研判》显示，中国集成电路封测行业产业链上中下游紧密协同，上游聚焦封装材料与设备供应，涵盖封装基板、引线框架、塑封料及光刻机、贴片机等核心环节，虽部分高端材料与设备仍依赖进口，但国产替代进程加速；中游为封装测试核心环节，技术迭代加速，先进封装成为主流，长电科技、通富微电、华天科技等企业通过技术引进与自主研发，在先进封装领域具备国际竞争力，同时传统封装技术持续优化，满足中低端市场需求；下游是行业需求的核心驱动力，覆盖消费电子、汽车电子、通信设备、工业自动化、人工智能、数据中心等多元化场景，其中消费电子与汽车电子为核心需求领域，汽车电子更是成为增长最快的细分领域，AI、HPC 等新兴场景则带动高端封测需求持续爆发。

（5）公司所处的行业地位情况

公司所处的行业细分领域为智能卡芯片及集成电路 DFN、QFN、FC 封装领域的封装材料及封装测试服务，市场发展情况如下：

1) 智能卡领域

据 Market.us Scoop 发布的《智能卡统计数据报告：安全、技术、控制维度划分》显示，智能卡利用内置微处理器和先进安全功能，使其能够应用于银行、电信、政府身份证和公共交通，采用 ISO/IEC7816 和 ISO/IEC14443 等标准，确保了全球互操作性和安全性。未来的发展预计将整合生物识别技术，扩大物联网（IoT）的应用，并提升移动兼容性，实现无缝、非接触式交易。随着技术的发展，智能卡将继续是安全的数字身份识别和支付系统的重要组成部分，满足对安全便捷解决方案日益增长的需求。全球智能卡市场以亚太区（APAC）为主导，占 39.4%。北美市场份额为 26.5%，欧洲占 23.0%。南美、中东和非洲（MEA）地区占比较小，分别占 6.4%和 4.7%。这凸显了亚太地区在智能卡市场中的重大影响。

全球智能卡市场收入预计 2025 年将达到 187 亿美元，预计市场将在 2029 年达到 236 亿美元。进入下一个十年，智能卡市场预计在 2030 年将创造 249 亿美元，2033 年将达到 296 亿美元。全球智能卡市场预计在 2023 年至 2028 年间以 8.7%的复合年增长率增长，主要得益于银行、医疗和交通行业的普及，以及对安全身份认证和身份验证需求的日益增长，这一持续增长反映了智能卡技术在全球各行业日益普及和整合的趋势。

据 Mordor Intelligence 发布的《智能卡市场分析报告》预计，全球智能卡市场规模为 2026 年 218.2 亿美元，预计 2031 年将达到 300.3 亿美元。新兴亚洲经济体强制实施非接触式 EMV 迁移、欧盟的 eIDAS2.0 数字钱包规则、以及偏好聚碳酸酯基底的企业可持续发展目标，共同将需求从支付部门转移到国家数字身份基础设施。与之前以磁条替换为主导的周期不同，今天的增长依赖于主权电子身份证项目和脱碳承诺，这些承诺将安全元素融入交通、医疗和福利系统。随着垂直整合半导体厂商提供交钥匙卡模块，竞争激烈度不断上升，这不仅压缩了纯卡局的利润率，也降低了价格敏感市场发卡机构的进入门槛。这些趋势为能够平衡法规合规、材料创新和供应链韧性的供应商开辟了多年机遇。

全球柔性引线框架业务领域主要企业为 Linxens、新恒汇以及 LG Innotek，公司市场规模稳居全球前二。

2) 蚀刻引线框架领域

蚀刻引线框架作为集成电路的芯片载体，在 5G 通信、人工智能、消费电子、可穿戴设备、汽车电子等

领域应用前景可观。根据新思界产业研究中心发布的《2026-2030 年全球及中国蚀刻引线框架行业研究及十五五规划分析报告》显示，蚀刻引线框架资金投入大、进入门槛高，但具有产品精度高、生产调整周期短、适合生产超薄产品等优点，可用于车规级 IGBT 模块、5G 通信芯片、物联网芯片、可穿戴设备芯片等先进封装中。随着生产技术进步，电子设备向微型化、集成化、多功能化方向发展，蚀刻引线框架应用需求持续增长，市场规模不断扩大。2025 年全球蚀刻引线框架市场规模约为 70.1 亿元，预计 2026-2030 年期间全球市场将以 4.2% 年复合增长率增长。在先进半导体封装需求不断上升的背景下，蚀刻引线框架增长率高于引线框架总体增速。

目前蚀刻引线框架的主要供应商集中在日本、韩国、中国香港及中国台湾地区，国内大陆地区自给率较低。全球半导体引线框架行业竞争格局中，头部企业优势明显。日本三井、长华科技（中国台湾）和日本新光等为行业传统强者，AAM（先进封装材料国际有限公司）等企业紧随其后。中国部分企业如新恒汇、康强电子、天水华洋等虽市场份额相对较小，但在积极追赶，不断提升技术与产能，努力突破高端蚀刻引线框架被境外厂商垄断的局面，推进国产替代进程。高端蚀刻引线框架领域，中国大陆生产厂商基础较为薄弱，产能受生产设备及技术工艺制约，仍在爬坡。境内只有少数企业可以批量供货，产能存在较明显缺口。在中美半导体贸易摩擦和国家对集成电路行业大力扶持的政策下，高端封装材料国产替代势在必行，为国内蚀刻引线框架企业提供了广阔的发展空间。

随着生产设备、工艺、材料等方面不断取得突破，本土企业持续推出一系列高性能产品，我国蚀刻引线框架行业发展进程有望加快。而新恒汇与国际行业头部企业相比，在经营规模和产品类别方面存在差异。但与国内同行业其他厂家相比，公司技术水平具有领先优势，产能位居行业前列。预计未来一段时间受到整个行业上升及国产替代趋势推动，市场发展空间较大。

3) 物联网 eSIM 芯片封测领域

随着消费电子轻薄化、可穿戴设备以及物联网终端漫游需求增加，eSIM 的应用有望在 2025 年加速。随着移动通讯设备的小型化与终端设备的多元化，嵌入式 SIM 卡的应用或迎来增长。据 GSMA Intelligence 预测，至 2025 年底，全球预计将有约 10 亿 eSIM 智能手机连接，2030 年将增长至 69 亿；据 Jupiter Research 测算，到 2026 年，全球使用 eSIM 技术的物联网连接数量将从 2023 年的 2200 万增长至 1.95 亿。下游智能手机厂商版本迭代，有望推动 eSIM 技术应用落地加速，进一步拉动 eSIM 渗透率提升。

据中国信通院发布《eSIM 技术和产业发展趋势研究（2025 年）》显示，eSIM 技术在消费电子领域的应用逐渐普及，支持 eSIM 技术的智能手机、智能手表、平板电脑、笔记本电脑等产品的种类和款型数量不断增多。随着 5G 技术的普及和物联网设备的大量增加，eSIM 技术在物联网领域呈现出强劲的增长势头和广泛的应用前景。在智能家居、医疗健康、汽车、物流、能源等行业，eSIM 的灵活配置和高效管理优势愈发明显。未来我国物联网芯片需求将随物联网技术在多领域应用拓展而增长，物联网芯片将向高性能、低功耗、智能化、集成化方向发展，与 5G、AI、边缘计算等技术融合加深，助力物联网设备更智能、高效运行。同时，产业生态逐步完善，芯片设计、制造、封装测试等环节协同合作，推动物联网芯片产业快速发展，市场份额和影响力有望进一步扩大。2030 年我国物联网芯片市场规模有望达到 2,393 亿元，年均复合增速约为 13.70%。

在集成电路国产化进程深化及全球 eSIM 标准（如 GSMA）快速普及的背景下，公司将紧抓机遇，全力推进高可靠性、高安全性的 eSIM 芯片封测产线的扩建和优化，快速提升规模化生产能力。通过严格的过程控制和持续的精益管理，确保产品良率处于行业领先水平。深化客户合作与市场拓展，加速新客户认证导入流程，构建多元、稳固的客户生态；通过数字化、智能化手段持续改进工艺，降低制造成本，提高整体运营效率和响应速度，力争成为 eSIM 封装生产领域行业领军企业。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产	2,113,485,048.66	1,359,933,194.74	55.41%	1,171,642,509.05
归属于上市公司股东的净资产	1,922,276,442.43	1,219,749,233.23	57.60%	1,032,243,455.51
	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入	923,112,220.08	842,072,366.89	9.62%	766,726,101.64
归属于上市公司股东的净利润	126,124,188.58	185,970,155.20	-32.18%	152,341,678.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,706,490.68	172,680,758.96	-34.73%	148,545,794.66
经营活动产生的现金流量净额	179,749,957.45	226,329,359.91	-20.58%	101,302,386.97
基本每股收益（元/股）	0.60	1.04	-42.31%	0.85
稀释每股收益（元/股）	0.60	1.04	-42.31%	0.85
加权平均净资产收益率	7.88%	16.52%	-8.64%	15.95%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	240,616,237.66	233,757,400.83	225,644,496.94	223,094,084.65
归属于上市公司股东的净利润	51,316,468.14	37,638,020.37	30,882,763.40	6,286,936.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,241,328.42	33,976,552.08	22,531,086.14	6,957,524.04
经营活动产生的现金流量净额	41,853,131.95	43,813,294.43	10,549,323.91	83,534,207.16

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,141	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,674	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
虞仁荣	境内自然人	23.56%	56,432,000.00	56,432,000.00	不适用				0.00
任志军	境内自然人	12.15%	29,116,000.00	29,116,000.00	不适用				0.00
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.78%	28,216,000.00	28,216,000.00	不适用				0.00
淄博高新城投资运营集团有限公司	国有法人	4.05%	9,708,700.00	9,708,700.00	质押				4,400,000.00
西藏龙芯投资有限公司	境内非国有法人	3.69%	8,833,300.00	8,833,300.00	不适用				0.00
共青城景枫投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.55%	8,495,100.00	8,495,100.00	不适用				0.00
陈同胜	境内自然人	3.05%	7,302,000.00	7,282,000.00	质押				4,500,000.00
共青城志林堂投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.84%	6,795,900.00	6,795,900.00	质押				6,795,900.00
中保投资有限责任公司-中国保险投资基金（有限合伙）	其他	2.50%	5,988,887.00	5,988,887.00	不适用				0.00
平安证券-招商银行-平安证券	其他	2.50%	5,988,886.00	5,988,886.00	不适用				0.00

新恒汇员工参与创业板战略配售集合资产管理计划						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，虞仁荣、任志军为一致行动人。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

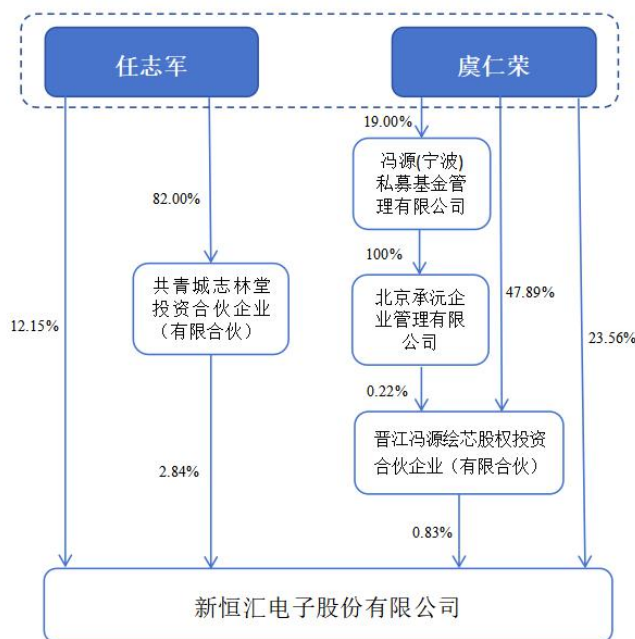
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

控股股东、实际控制人



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

无